



114 年度工研院量測技術發展中心
形貌光學量測、顯示器 LED 檢測及其他等相關研發成果
讓與暨專屬授權案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與或專屬授權之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與/專屬授權標的：

（一）本案件包含專利 33 案 54 件（以下簡稱：「本案件標的」）。

（二）投標廠商得依實際需求，就「讓與模式」及/或「專屬授權模式」參與投標。惟本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，若「讓與模式」有流標、廢標或無效投標者，始進行「專屬授權模式」之開標審議等程序；若「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標、無效投標或未通過相關主管機關之核准者，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）114 年 5 月 9 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 5 月 8 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「114 年度工研院量測技術發展中心形貌光學量測、顯示器 LED 檢測及其他等相關研發成果讓與暨專屬授權案-公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 5 月 8 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本案件公告日起至截標日 114 年 5 月 19 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。



五、投標方法：

(一) 本案件採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件(如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「114 年度工研院量測技術發展中心形貌光學量測、顯示器 LED 檢測及其他等相關研發成果讓與暨專屬授權案」，於截標日 114 年 5 月 19 日 17 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐 收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介(20%)
2. 公司財務狀況(20%)
3. 公司營運／研發能力(20%)
4. 「本案件標的」運用規劃(30%)
5. 國內產業效益(10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本案件採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。(「本案件標的」以同一發明為一案。)

(五) 本案件不得共同投標或就同一模式重複投標，但就不同模式(即「讓與模式」或「專屬授權模式」)得分別投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依「八、決標方法」第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本案件交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

- (一) 本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，「讓與模式」於流標、廢標或無效投標後，始進行「專屬授權模式」之決標審議等程序；「讓與模式」之決標方式須通過初審（114 年 5 月 21 日）及複審（114 年 5 月 28 日）程序，「專屬授權模式」亦須經初審（114 年 5 月 21 日）及複審（114 年 5 月 28 日）程序，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、近兩年財報資料、商業營運計畫書、價格封等進行形式審查及確認。

- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上超過及格分之投標廠商之投標金額超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 開標時將請律師到場監標。
- (八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- (九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
- (十) 對於「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標或無效投標之「本案件標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」原則上應具備「九、契約事項」所載之條件；但基於產業運用效益等考量，雙方得於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」中另議合法合規之條件，工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」與否之權利。
- (二) 得標廠商如無正當理由屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- (三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院

審議委員會審查通過，方得簽約。

- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「本案件標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與/專屬授權費用，讓與/專屬授權費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」/「專屬授權契約書」且生效時，本案件簽約保證金移充為之讓與/專屬授權費用。「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效，得標廠商充分了解「本案件標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。「專屬授權契約書」自其所載生效日起生效，「授權標的」之授權期間自「專屬授權契約書」生效日起 10 年，惟專利有效期間早於前述期間者，該專利授權期間則以其專利有效期間為準。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「本案件標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「本案件標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「本案件標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」/「專屬授權契約書」僅為工研院同意讓與/專屬授權「本案件標的」予得標廠商。工研院亦僅依本案件公告日之「本案件標的」現狀讓與/專屬授權得標廠商，工研院不擔保「本案件標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「本案件標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「本案件標的」所製造產品之產品責任。「本案件標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「本案件標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須

負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效後，「本案件標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「本案件標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「本案件標的」之諮詢講解或訓練之義務。

- (十) 「本案件標的」之讓與/專屬授權登記手續全權由工研院依工研院作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與/專屬授權登記手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效之日起負擔「本案件標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「本案件標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「本案件標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部產業技術司，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：
1. 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 2. 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 3. 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 4. 得標廠商讓與「本案件標的」之對象非我國研究機構或企業者。
- (十二) 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」，並得將「本案件標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「本案件標的」收歸國有：
1. 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「本案件標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
 2. 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「本案件標的」者。
 3. 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

- (十三) 得標廠商如將「本案件標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」/「專屬授權契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
- (十四) 若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與、專屬授權、輾轉讓與或專屬授權「本案件標的」予非專利實施實體 (Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」)，或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者 (以下簡稱「未經同意之受讓者」)，造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「本案件標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「本案件標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。
- (十五) 得標廠商應使所有「後手」遵守「九、契約事項」第七項至第九項、第十一項至第十七項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
- (十六) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「本案件標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效後對第三人就「本案件標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
- (十七) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上 (以下簡稱「股權變動」) 時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契



約書」/「專屬授權契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或以書面另議新約。

- (十八) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「本案件標的」工作，若得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「本案件標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或將「本案件標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本案件公告為「讓與契約書」/「專屬授權契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本案件公告、「本案件標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本案件公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 桂小姐。

電話：(03) 591-8009，傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：ManTing@itri.org.tw。

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

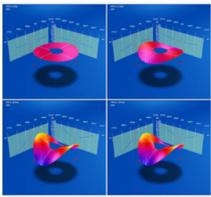
附件一：本案件標的簡介

(歡迎產業界針對有興趣之標的報名公開說明會了解相關資訊。)

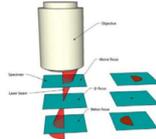
一、形貌光學量測技術

- 因應產業生產線需求，各家廠商開發自有完整系統技術，在過程中ITRI也開發相關系統，**為因應量測速度、動態量測、解析度、系統組裝校正、自動對焦等**，提出部分功能提升的相關技術專利，產業以採購整體設備為考量，惟採用國際大廠解決方案的同時，相關專利仍具價值可跨域應用，讓與推廣專利可協助產業。

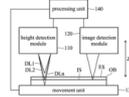
國際大廠的解決方案



動態3D量測系統
(4D technology Dynamic Interferometry)



目前主流對焦產品如WDI WISE DEVICE INC 使用共焦方法實現，可與顯微系統整合並達到0.4 秒對焦時間，系統應用彈性大。



自動對焦方法與裝置

P07010013
(專利證號:US 8952305)

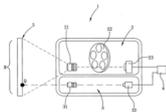
二、顯示器LED檢測及其他相關技術

LED晶粒點測機產業

- LED晶片點測與分選設備廠商包含**惠特、梭特、久元、致茂、旺矽、豪勉**，各家廠商開發自有完整系統技術，ITRI也提出部分功能量測相關專利技術，相關專利仍具價值可跨域應用，讓與推廣專利可協助產業。

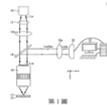
顯示器產業

- 為因應國內顯示器產業發展如液晶顯示器發展，過程中ITRI也開發相關量測專利技術，如**觸控功能、廣視角等功能需要配向膜、導電膜等功能性量測技術與量產檢測技術**，相關專利仍具價值可跨域應用，讓與推廣專利可協助產業。



P07000012
(專利證號:1512274)

影像式彩色分析儀之校正方法及量測裝置



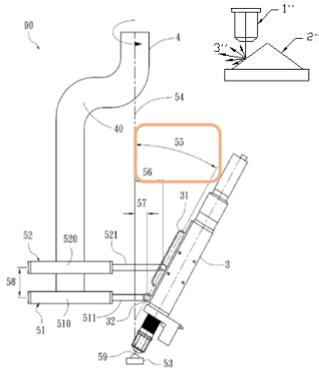
P07030005
(專利證號:1542864)

異向性量測系統、異向性量測方法及其校正方法

US7619190(P07960020US)

可調整傾角之形貌檢測裝置

「精準測量，驅動未來——
無論是汽車、醫療還是工業，每一道縫隙與細節皆經驗證。」



產品：【光學顯微鏡】

突破傳統鏡頭無法傾斜的難題，
本技術**鏡頭可傾斜（±30度）**能對大斜率表面進行檢測，
配合適用於半導體、光學元件等高精度量測需求。



專利權範圍

可調傾斜的表面輪廓儀，包括機架（4）、
表面檢測單元（3），第一/第二傾斜調整裝置（51、52），
使表面檢測單元的傾斜角度可調，以獲取樣品的表面輪廓。



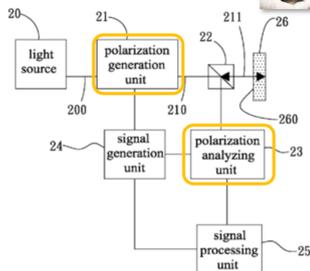
產業應用

- 精密加工機：上銀、台中精機、協高
- 半導體設備廠：致茂、均豪、(JP) 愛德萬測試 (Advantest Corporation)、(US) 科磊 (KLA)

US8982346(P07010024US)

光學旋轉角度量測系統及其方法

「被 Fuji、Samsung、達隆、Magic Leap 進行專利引用，
精準旋光技術連結血糖監測與智慧視界！」



產品：【非侵入血糖機】

獨家旋光檢測技術，搭配非雷射光源與時態調制演算，
確保高安全性、卓越解析度與穩定訊號。



專利權範圍

測量光學活性物質旋轉角度的系統，
此系統包括光源（20）、偏振產生單元（21）、
偏振分析單元（23）、訊號產生單元（24）與分光單元（22），
透過可控相位調制器，調整偏振態，
同時分析出射光束，以計算光學活性物質的旋轉角度。



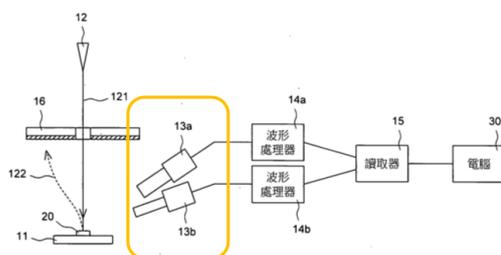
產業應用

- 醫療設備設計製造商：五鼎生技、訊映光電
- ICT 零件生產：環隆科技
- 半導體製程量測：(US) KLA
- AR/VR 製造商：HTC、Google、Microsoft

TWI573165(P07030026TW)

電子顯微鏡、讀取器以及擷取元素頻譜之方法

「已被日本兩大精密儀器領導品牌——**島津製作所**與**日立製作所**
所引用，彰顯出此技術在國際材料分析領域的重要性。」



產品：【電子顯微鏡】

不同角度下擷取能量散射X射線譜（EDX），
能夠在高解析度影像下，同時進行化學成分與元素分析，
適用於材料科學、半導體檢測等領域。



專利權範圍

電子顯微鏡，透過帶電粒子束轟擊樣品，
並利用多個立體角或規格不同的元素頻譜
偵測器（13a、13b）檢測放射出的 X 光，
再由讀取器（15）校正與累加頻譜訊號，
以獲取樣品的元素頻譜。



產業應用

- (TW) 台灣電鏡儀器、(US) Thermo Fisher Scientific、
(JP) JEOL Ltd.、(GE) Carl Zeiss AG



附件二：專利清單

(一) 形貌光學量測：18 案 31 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P0700001TW	金屬薄膜量測方法	中華民國	獲證	TWI463110	20141201	20310510	經濟部產業技術司	工研院	
2	2	P07000024TW	自動對焦裝置與方法	中華民國	獲證	TWI470299	20150121	20311204	經濟部產業技術司	工研院	
3	3	P07010007TW	量測系統與量測方法	中華民國	獲證	TWI467125	20150101	20320923	經濟部產業技術司	工研院	
	4	P07010007US	量測系統與量測方法	美國	獲證	US8830458	20140909	20330228	經濟部產業技術司	工研院	
4	5	P07010013US	自動對焦系統與自動對焦方法	美國	獲證	US8952305	20150210	20330917	經濟部產業技術司	工研院	
5	6	P07010020CN	光學旋轉裝置以及干涉相位差顯微鏡	中國大陸	獲證	CN103809284	20170728	20321129	經濟部產業技術司	工研院	
	7	P07010020TW	光學旋轉裝置以及干涉相位差顯微鏡	中華民國	獲證	TWI463175	20141201	20321106	經濟部產業技術司	工研院	
6	8	P07020003TW	接合層的厚度量測系統與方法	中華民國	獲證	TWI499756	20150911	20340101	經濟部產業技術司	工研院	
7	9	P07020021CN	結合三維及二維形貌的量測方法及裝置	中國大陸	獲證	CN104677307	20180323	20331212	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	10	P07020021TW	結合三維及二維形貌之量測方法及裝置	中華民國	獲證	TWI489101	20150621	20331201	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
8	11	P07030004US	大範圍即時熔池溫度量測	美國	獲證	US9533375	20170103	20350826	經濟部產業技術司	工研院	
9	12	P07030010CN	光學校正裝置與光學校正方法	中國大陸	獲證	CN105783708	20190528	20341221	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	13	P07030010TW	光學校正裝置與光學校正方法	中華民國	獲證	TWI518300	20160121	20341125	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
10	14	P07030025CN	差分式三角量測系統及其方法	中國大陸	獲證	CN105716522	20180427	20350726	經濟部產業技術司	工研院	
	15	P07030025TW	差分式三角量測系統及其方法	中華民國	獲證	TWI565928	20170111	20350625	經濟部產業技術司	工研院	
11	16	P07040010TW	結構光產生裝置、量測系統及其方法	中華民國	獲證	TWI567364	20170121	20350907	經濟部產業技術司	工研院	
	17	P07040010US	結構光產生裝置、量測系統及其方法	美國	獲證	US10105906	20181023	20360711	經濟部產業技術司	工研院	
12	18	P07050006TW	平面度量測裝置	中華民國	獲證	TWI610062	20180101	20361026	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
13	19	P07960018CN	疊對量測結構及方法	中國大陸	獲證	CN101436580	20101117	20271111	經濟部產業技術司	工研院	
	20	P07960018TW	疊對量測結構及方法	中華民國	獲證	TWI347428	20110821	20271101	經濟部產業技術司	工研院	
	21	P07960018US	疊對量測結構及方法	美國	獲證	US7652776	20100126	20280214	經濟部產業技術司	工研院	
14	22	P07960020CN	可調整傾角之形貌檢測裝置	中國大陸	獲證	CN101413787	20100623	20271017	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	23	P07960020TW	可調整傾角之形貌檢測裝置	中華民國	獲證	TWI340232	20110411	20270920	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	24	P07960020US	可調整傾角之形貌檢測裝置	美國	獲證	US7619190	20091117	20280330	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
15	25	P07980018TW	干涉相位差量測方法及其系統	中華民國	獲證	TWI417519	20131201	20291209	經濟部產業技術司	工研院	
16	26	P07980024TW	二維陣列疊對圖樣之設計方法、疊對誤差量測方法及其量測系統	中華民國	獲證	TWI401549	20130711	20291201	經濟部產業技術司	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
16	27	P07980024US	二維陣列疊對圖樣之設計方法、疊對誤差量測方法及其量測系統	美國	獲證	US8321821	20121127	20301208	經濟部產業技術司	工研院	
17	28	P07980025TW	二維陣列疊對圖樣組之設計方法、疊對誤差量測方法及其量測系統	中華民國	獲證	TWI417942	20131201	20291216	經濟部產業技術司	工研院	
	29	P07980025US	二維陣列疊對圖樣組之設計方法、疊對誤差量測方法及其量測系統	美國	獲證	US8250497	20120821	20300928	經濟部產業技術司	工研院	
18	30	P07990015TW	孔洞底部形貌的量測方法	中華民國	獲證	TWI424145	20140121	20301207	經濟部產業技術司	工研院	非專屬授權中
	31	P07990015US	孔洞底部形貌的量測方法	美國	獲證	US8537213	20130917	20311226	經濟部產業技術司	工研院	

(二) 顯示器 LED 檢測：11 案 18 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
19	32	P07000012CN	圖像式彩色分析儀的校正方法及測量裝置	中國大陸	獲證	CN103017907	20150121	20311027	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	33	P07000012TW	影像式彩色分析儀之校正方法及量測裝置	中華民國	獲證	TWI512274	20151211	20310926	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
20	34	P07000032TW	影像信號選擇裝置、量測系統與立體影像量測方法	中華民國	獲證	TWI434030	20140411	20311226	經濟部產業技術司	工研院	
21	35	P07000034TW	大動態範圍的電壓產生器與電壓產生方法	中華民國	獲證	TWI467908	20150101	20311222	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
22	36	P07010032CN	顯示器量測裝置	中國大陸	獲證	CN103903538	20160706	20330129	經濟部產業技術司	工研院	
	37	P07010032US	顯示器量測裝置	美國	獲證	US8912483	20141216	20330814	經濟部產業技術司	工研院	
23	38	P07010040CN	測量裝置以及測量方法	中國大陸	獲證	CN103884424	20151104	20321224	經濟部產業技術司	工研院	
	39	P07010040TW	量測裝置以及量測方法	中華民國	獲證	TWI467141	20150101	20321218	經濟部產業技術司	工研院	
24	40	P07030005CN	異向性量測系統、異向性量測方法及其校正方法	中國大陸	獲證	CN106154593	20190802	20350322	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	41	P07030005TW	異向性量測系統、異向性量測方法及其校正方法	中華民國	獲證	TWI542864	20160721	20341229	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
25	42	P07030009TW	非接觸式渦電流檢測裝置及其控制方法	中華民國	獲證	TWI509242	20151121	20341214	經濟部產業技術司	工研院	
26	43	P07040011TW	多點光譜系統	中華民國	獲證	TWI579540	20170421	20351201	經濟部產業技術司	工研院	
	44	P07040011US	多點光譜系統	美國	獲證	US9948868	20180417	20360725	經濟部產業技術司	工研院	
27	45	P07050008TW	影像感測器以及影像感測方法	中華民國	獲證	TWI602435	20171011	20361128	經濟部產業技術司	工研院	
	46	P07050008US	影像感測器以及影像感測方法	美國	獲證	US10477122	20191112	20370425	經濟部產業技術司	工研院	
28	47	P07060005TW	多層膜之檢測系統及其方法	中華民國	獲證	TWI660182	20190521	20380102	經濟部產業技術司	工研院	
	48	P07060005US	多層膜之檢測系統及其方法	美國	獲證	US10429318	20191001	20380527	經濟部產業技術司	工研院	
29	49	P07970003TW	薄膜光學檢測裝置	中華民國	獲證	TWI386638	20130221	20281023	經濟部產業技術司	工研院;明志科技大學;	



(三) 其他：4 案 5 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
30	50	P07010024US	光學旋轉角度量測系統及其方法	美國	獲證	US8982346	20150317	20330304	經濟部產業技術司	工研院	
31	51	P07030003TW	用於高能射線之非直接式感測器以及感測模組	中華民國	獲證	TWI546943	20160821	20341023	經濟部產業技術司	工研院	
32	52	P07030026TW	電子顯微鏡、讀取器以及擷取元素頻譜之方法	中華民國	獲證	TWI573165	20170301	20341208	工研院	工研院	
	53	P07030026US	電子顯微鏡、讀取器以及擷取元素頻譜之方法	美國	獲證	US10002741	20180619	20360105	工研院	工研院	
33	54	P07990016TW	塑膠膜片之雙表面微結構成型機構及方法	中華民國	獲證	TWI426992	20140221	20301207	經濟部產業技術司	工研院	

【備註】本案件公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。